

1. 外形尺寸

1.1 (见图 1) 及材料(单位: mm)

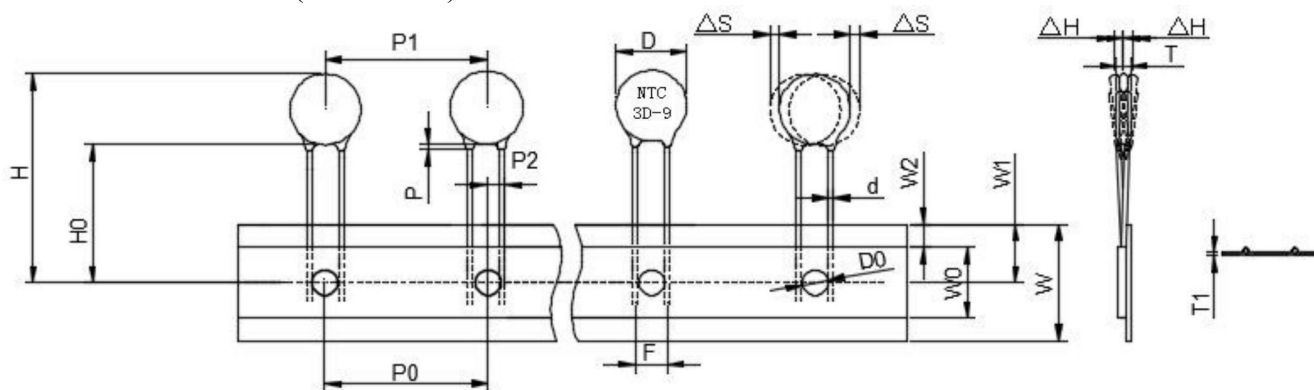


图 1

D	D0	H	H0	ΔH	P	P0	P1	P2
Max10.5	4±0.2	Max33.0	20.0±1.0	Max2.0	Max4.0	12.7±1	12.7±1	3.75±0.7
F	d	T	T1	ΔS	W	W0	W1	W2
7.5±0.5	0.8±0.05	Max5.0	0.6±0.3	Max1.3	18±1	Min 10.0	9±1	Max3.0

1.2 封装形式: 包封引线型

1.3 包封材料: 硅树脂

1.4 包封颜色: 绿色

标志颜色: 黑色印字

1.5 引线材料: 镀锡铜线

1.6 引线形状: 直脚型

1.7 无铅 (符合 ROHS 要求)

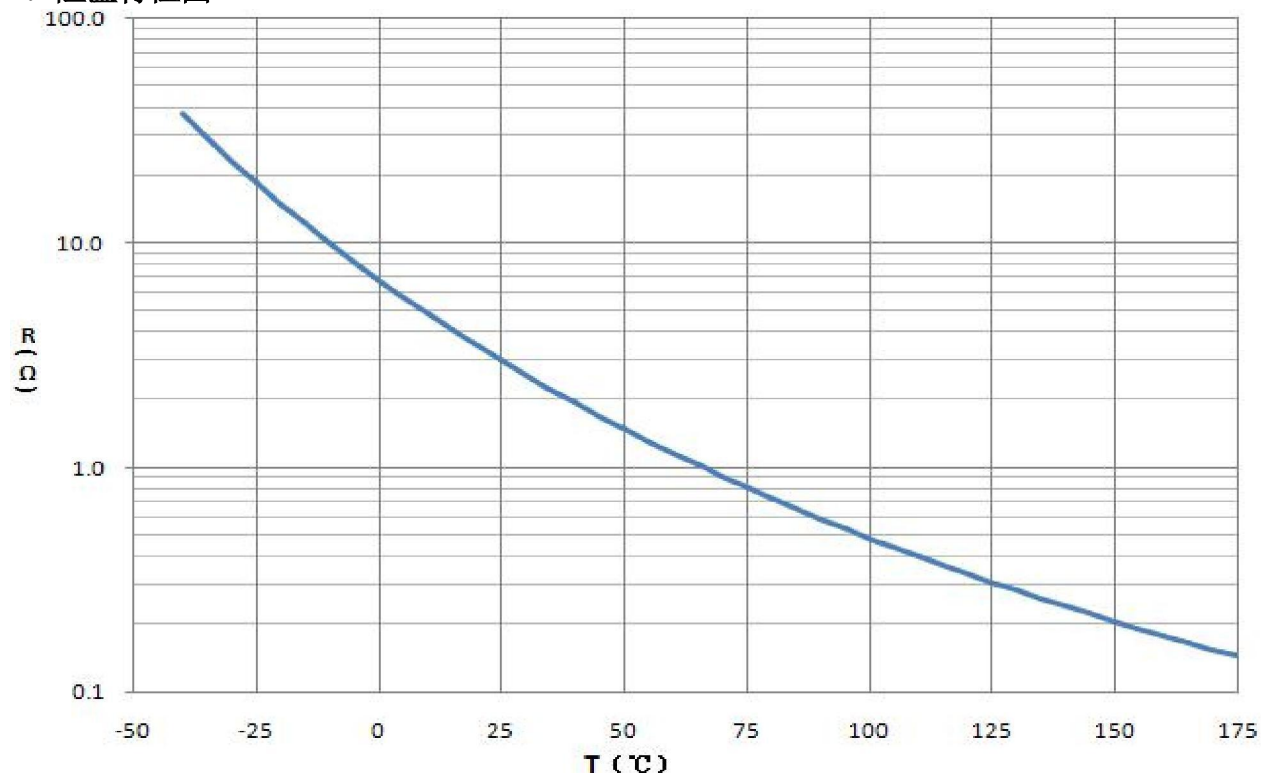
2. 电参数

项目	参数要求
额定零功率电阻 R25	$3\ \Omega \pm 20\%$
B 值 (B _{25/50})	$2600K \pm 10\%$
最大稳态电流(I _{max})	5.0A
热耗散系数(δ_{th})	$\geq 13mW/^{\circ}C$
热时间常数(τ_c)	$\leq 43S$
最大允许容值 (C _T)	(240VAC) 220 μ F
耐电压 (V)	500V/DC 1min 无击穿与飞弧
工作温度范围(T)	-40~+170 $^{\circ}C$
绝缘电阻 (M Ω)	500V/DC 1min $\geq 500M\Omega$

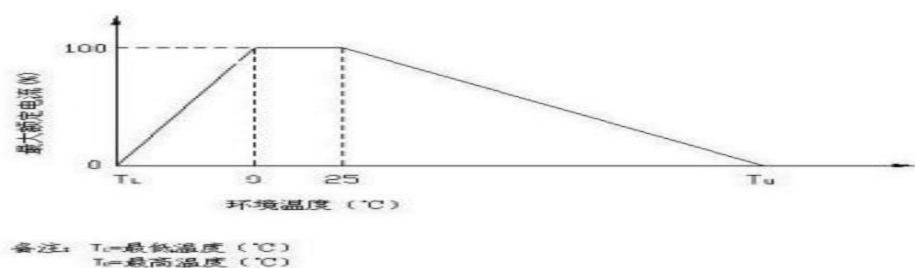
3. 可靠性

	术语名称	说明	性能要求
3.1	引出端强度	拉力: 线径 (mm) 拉力 (N) $0.5 < d \leq 0.8$ 10 $0.8 < d \leq 1.25$ 20 时间: 10 ± 1 秒 试验完成后, 在常温常湿下恢复 1~ 2Hr 后, 复测 R25 额定零功率电阻.	外观无可见损伤 $ \Delta R/R \leq 25\%$
3.2	可焊性	温度为 $255 \pm 5^{\circ}C$, 时间 2-3S. 见附件 1 (无铅波峰焊)	上锡面积 $\geq 95\%$
3.3	耐焊接热	锡锅温度 $260^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$ 、浸入深度距电阻体 6mm, 时间 $10 \pm 1S$, 试验完成后, 在常温常湿下恢复 1~ 2Hr 后, 复测 R25 额定零功率电阻.	外观无可见损伤 $ \Delta R/R \leq 25\%$
3.4	稳态湿热	温度 $40 \pm 2^{\circ}C$ 、湿度 $93 \pm 2\%$ 的环境下, 存放 $1000H \pm 24H$ 后, 再在常温条件下恢复 24 小时后, 复测 R25 额定零功率电阻.	外观无可见损伤 $ \Delta R/R \leq 25\%$
3.5	温度快速变化	$-30^{\circ}C \times 30Min \rightarrow 25^{\circ}C \times 5Min \rightarrow 150^{\circ}C \times 30Min \rightarrow 25^{\circ}C \times 5Min$, 循环 5 次, 试验完成后, 在常温常湿下恢复 1~ 2Hr 后, 复测 R25 额定零功率电阻.	外观无可见损伤 $ \Delta R/R \leq 25\%$
3.6	高温贮存	温度: $125 \pm 5^{\circ}C$, 时间 $1000H \pm 24H$, 试验完成后, 在常温常湿下恢复 1~ 2Hr 后, 复测 R25 额定零功率电阻.	外观无可见损伤 $ \Delta R/R \leq 25\%$
3.7	低温贮存	温度: $-40 \pm 5^{\circ}C$, 时间 $1000H \pm 24H$, 试验完成后, 在常温常湿下恢复 1~ 2Hr 后, 复测 R25 额定零功率电阻.	外观无可见损伤 $ \Delta R/R \leq 25\%$
3.8	最大稳态电流耐久性	在室温下热敏电阻器持续施加最大稳态电流 $1000 \pm 24h$. 试验完成后, 在常温常湿下恢复 1~ 2Hr 后, 复测 R25 额定零功率电阻.	外观无可见损伤 $ \Delta R/R \leq 25\%$
3.9	最大允许电容量	最大电容量冲击容量 1000 μ F.	外观无可见损伤 $ \Delta R/R \leq 25\%$
3.10	室温通断负荷寿命 (耐久性)	施加最大稳态电流 I _{max} , 间歇闭合 50Ms, 恢复 5 倍时间, 循环 1000 次, 试验完成后, 在常温常湿下恢复 1~ 2Hr 后, 复测 R25 额定零功率电阻.	外观无可见损伤 $ \Delta R/R \leq 25\%$

4. 阻温特性图



5. 降电流曲线



6. 包装

6.1 盒包装 1000 只/盒, 10 盒/箱包装, 10000 只/箱。

6.2 包装箱粘贴标签。

标签上应注明:

- 产品型号
- 额定零功率电阻值
- 产品数量
- 制造厂
- 生产年月
- 产品材料代码

6.3 包装纸箱上的标记应符合 GB191 有关规定。

6.4 包装纸箱内的空隙应塞紧, 包装纸箱应用编织带或胶纸带扎牢。

7.注意事项

7.1 MF72 型负温度热敏电阻器是根据特定用途设计制造的，用于抑制浪涌电流，因此只能用于规定的场合。

7.2 MF72型负温度热敏电阻器应在规定的标准条件下使用，否则，由于使用不当，将导致产品性能下降，甚至损坏失效。

7.3 使用时，工作电流的选择不得超过参数表的规定。

7.4 勿在腐蚀性、挥发性、易燃性气氛环境和靠近水、盐、油污的场合以及真空、低气压、高气压条件下使用。

7.5 应在 $-10^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ 温度内，相对湿度低于75%的条件下贮存，并避免温度骤变、阳光直射、腐蚀气氛、粉尘环境以及机械力的破坏。

7.6 烙铁焊接时，焊接处距涂装层距离至少 2mm，焊接温度应低于 360°C ，焊接时间 $<3\text{ses}$ 。

8.存储条件:

存储温度 $-10^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$

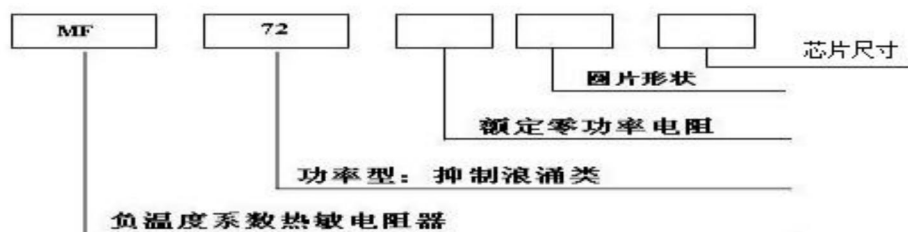
存储湿度 $\leq 75\% \text{ RH}$

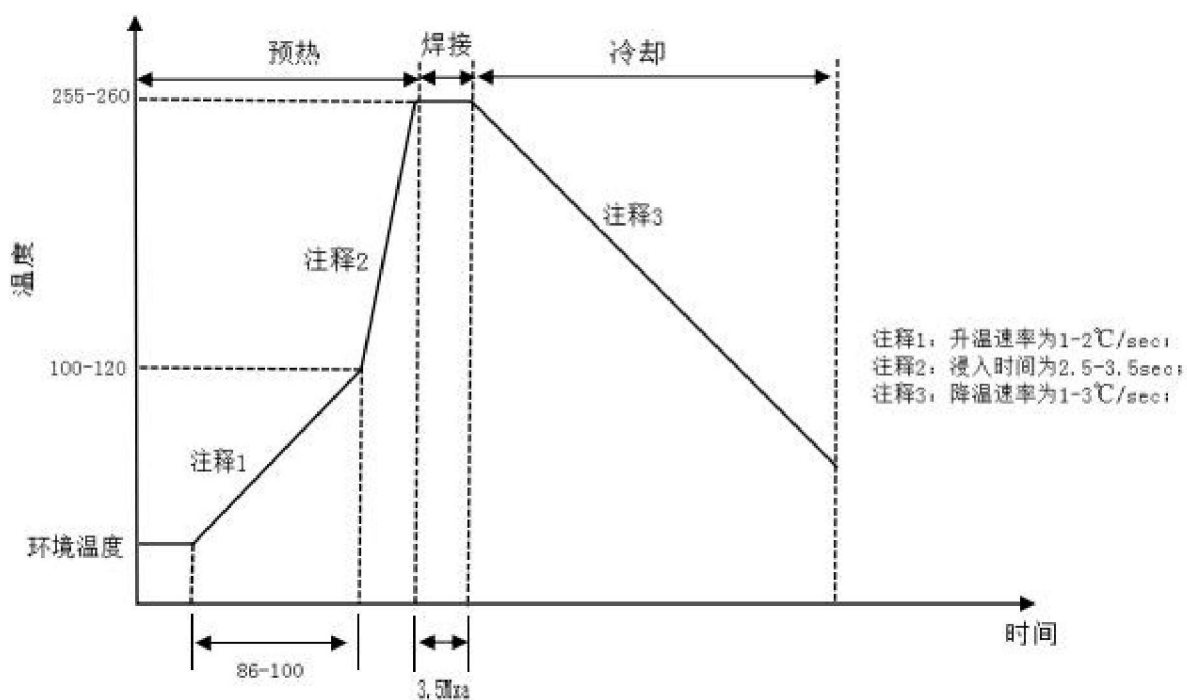
避免放在有腐蚀性气体环境，与光照直射的环境。

使用后需密封保存。

包装打开后需重新密封保存，贮存期 1 年，超过贮存期，可按本标准规定的项目重新检验，如符合要求仍可使用。

9.型号说明



附件 1

二. 无铅波峰焊制程温度:

1. 预热温度 100-120℃，时间 86-100 秒，升温速率为 1-2℃/sec;
2. 零件从预热后即进入 255-260℃的熔锡中；浸入时间为 2.5-3.5sec；
3. 零件焊接后的降温速率为 1-3℃/sec；
4. 焊接总时间为 3.5min

为保证零件过波峰焊接时能够承受热冲击，零件之耐温规格必须高于波峰焊接之温度曲线最大温度，即 260℃ 以上。